

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006年10月19日 (19.10.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/109744 A1

- (51) 国際特許分類:
C08G 59/14 (2006.01) C08L 63/00 (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/307491
- (22) 国際出願日: 2006年4月7日 (07.04.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2005-110584 2005年4月7日 (07.04.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭化成ケミカルズ株式会社 (Asahi Kasei Chemicals Corporation) [JP/JP]; 〒1008440 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 浦川 政明 (URAKAWA, Masaaki). 新井 雄史 (ARAI, Takeshi).
- (74) 代理人: 小栗 昌平 (OGURI, Shohei); 〒1050003 東京都港区西新橋一丁目7番13号 栄光特許事務所 Tokyo, 外 (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IL, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: EPOXY RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: エポキシ樹脂組成物

(57) **Abstract:** This invention provides an epoxy resin composition that can provide a printed wiring board having excellent heat resistance, adhesion, prepreg storage stability, and insulation reliability. The epoxy resin composition comprises (A) an oxazolidone ring-containing epoxy resin, (B) a novolak-type epoxy resin, (C) a guanidine derivative, and (D) imidazoles and is characterized in that the component (A) simultaneously contains an oxazolidone ring and an isocyanuric ring, the IR absorbance ratio of the isocyanuric ring to the oxazolidone ring is not less than 0.01 and not more than 0.1, the weight ratio between the component (A) and the component (B) is 5 : 95 to 95 : 5, the content of the component (C) and the content of the component (D) are 0.01 to 5 parts by weight and not more than 0.08 part by weight, respectively, based on 100 parts by weight in total of the weight of the epoxy resin containing the components (A) and (B), and the content of bromine based on a weight obtained by subtracting the weights of the components (C) and (D) from the weight of the resin composition is not less than 10% by weight and not more than 20% by weight.

(57) 要約: 耐熱性、接着性、プリプレグ保存安定性および絶縁信頼性に優れたプリント配線板が得られるエポキシ樹脂組成物を提供すること。(A) オキサゾリドン環を含むエポキシ樹脂、(B) ノボラック型エポキシ樹脂、(C) グアニジン誘導体、および(D) イミダゾール類を成分として含むエポキシ樹脂組成物であって、(A) 成分がオキサゾリドン環と同時にイソシアヌル環を含み、オキサゾリドン環に対するイソシアヌル環のIR吸光度の比が0.01以上0.1以下であり、(A)成分と(B)成分の重量比が5:95~95:5であり、更に(C)成分と(D)成分の含有量が、(A)成分と(B)成分を含むエポキシ樹脂の重量の和100重量部あたり、それぞれ0.01~5重量部、0.08重量部以下であり、かつ、樹脂組成物から(C)成分と(D)成分を除いた重量を基準として臭素含有率が10重量%以上かつ20重量%以下であることを特徴とするエポキシ樹脂組成物。

WO 2006/109744 A1